

此檔案以縮圖形式顯示。
經由客戶專區「DISCO eLearning Campus」頁面，
即可以高畫質瀏覽檔案。
若您尚未登入「DISCO eLearning Campus」專區服務，
請洽詢各地服務據點的客服人員。

迪思科用語辭典

<精密加工工具篇>

Rev. 1.00

Training Center
Global Training Department
DISCO Corporation

© DISCO Corporation

索引

A	D
Air Cut 85	打磨 86
凹刀 45	刀痕 40
	刀痕轉移 50
B	刀夾側 44
邊緣裂角 96	刀刃寬 69
表面粗糙度 72	砥石三要素 5
表面積塵 73	磨盤 80
表面修整 74	電鍍結合劑 12
Burning 73	Dressing 35
	對位記號 79
C	E
cBN 17	E/K 比 41
超級研磨顆粒 15	Filler 96
齒排列 67	Escape Cut 75
Concentration 22	
Contamination 69	F
Creep-Feed 62	飛邊 48
粗研磨輪 54	Filler 14
	Flange 29
	Flat Dressing 46
	磨粒 81

G	L
高規格切削刀片 30	連續排列 66
GC 18	黏合金輪軸 24
Gettering Site 58	輪軸 24
工作盤材料 63	探深 35
磨痕 65	
H	M
Hub Blade 26	磨刀 35
Hub Mount 24	磨刀板 36
Hubless Blade 28	磨刀修整 35
	磨刀針 76
I	厚耗量 78
In-Feed 61	磨盤 71
	磨輪切削水 95
	磨輪壽命 77
J	N
集中度 22	內部噴嘴 93
基座 24	內刃 91
加工精 21	內外研磨 89
尖銳邊角 88	Nut 帶 44
角狀 31	
結合劑 7	P
結合劑未潤 13	拋光磨輪 56
金屬結合劑 10	偏心 47
	平邊磨刀 46
K	Pre-cut 37
可使用的刀片露出量 42	Prime Grade 30
空切 85	普通研磨顆粒 16
塊狀 32	

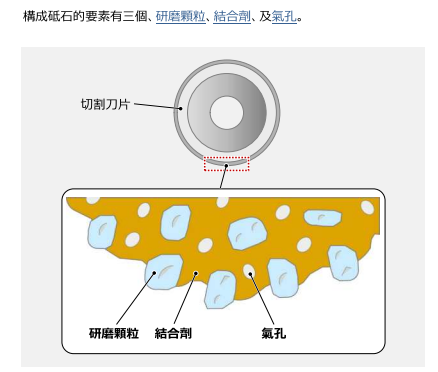
Q	T
氣孔 8	陶瓷結合劑 11
切割刀片 25	填充劑 14
切刃 34	退出加工 75
切屑痕 71	
R	V
熱固性樹脂結合劑 9	V 型刀片 38
溶化 81	
溶解 81	W
軟刀 27	WA 19
軟刀刀座 29	外部噴嘴 94
	外觀比例 33
S	內外研磨 90
Saw Mark 71	外刃 92
Scratch 65	彎曲斜切 51
Self-Grinding 70	網眼尺寸 23
Self-Sharpening 20	
Sharp Edge 88	X
鉋行 49	磁研磨輪 55
深溝鑄結 62	斜切 52
樹脂結合劑 9	旋轉中心偏移量 82
Slant Cut 52	
Spark Out 74	
Spindle 帶 43	
Stress Relief 57	
碎屑 21	

Y	Z
研盤齒 64	真圓度偏差 47
研盤齒長度 68	真圓度調整 39
研盤齒間隙 87	軸向進給 61
研盤齒高度 69	主軸削 43
研盤顆粒 6	接觸邊界 58
研盤粒徑 23	接觸線 58
研盤輪 53	接觸乾式拋光磨輪 59
研盤修整 84	自發刃 20
修整厚度 60	自銳性 20
修整量 60	自體研磨 70
修整體積 60	
異物附著 83	
磨刀 26	
磨刀刀座 28	
磨刀釋放 57	
有效刀片露出量 42	
張切割 37	

砥石三要素

dǐ shí sān yào sù

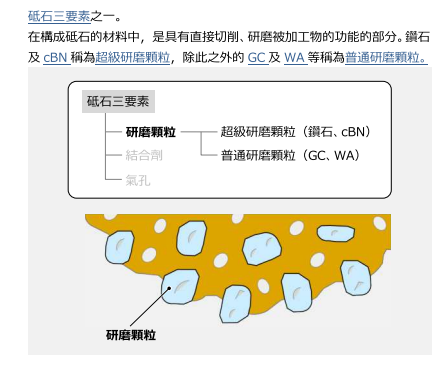
類別：鑽石加工相關



研磨顆粒

yán mó kē lì

類別：鑽石加工相關

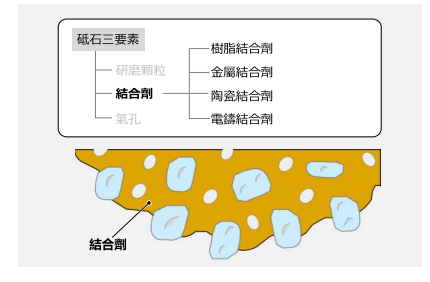


結合劑

jié hé jì

類別：鑽石加工相關

砥石三要素之一。
製造刀片及磨輪時，用來固定研磨顆粒所使用的材料。
主要分為樹脂結合劑，金屬結合劑，陶瓷結合劑，及電鍍結合劑。
根據結合劑的特性，加工效率及加工品質會受很大的影響。

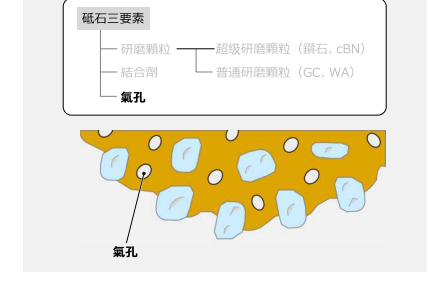


氣孔

qì kǒng

類別：鑽石加工相關

砥石三要素之一。
這個指的是在用來固定（結合）鑽石，cBN 等研磨顆粒的結合劑中存在的氣泡，孔洞。



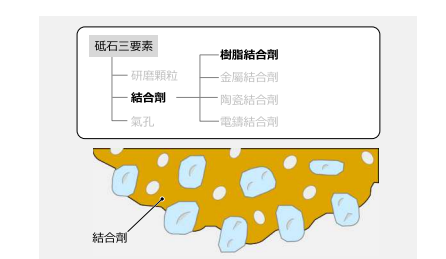
樹脂結合劑

熱固性樹脂結合劑

shù zhī jié hé jì / rè gù xìng shù zhī jié hé jì

類別：鑽石加工相關

結合劑的一種。主要成分為樹脂，也有與填充劑 (Filler) 混合後燒製的結合劑。在所有結合劑中的耐磨耗性是最低的。彈性佳，可以減少在切削時對被加工物的損傷。

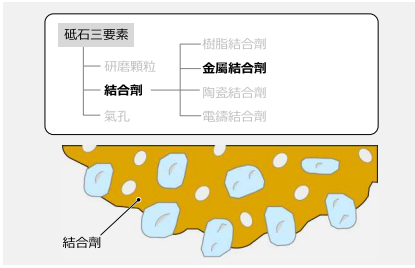


金屬結合劑

jīn shǔ jié hé jì

類別：鑽石加工相關

結合劑的一種。用粉末冶金將鑽石及 cBN 等多種金屬粉末燒結·成形。相對於樹脂結合劑，其耐磨耗性要更高。

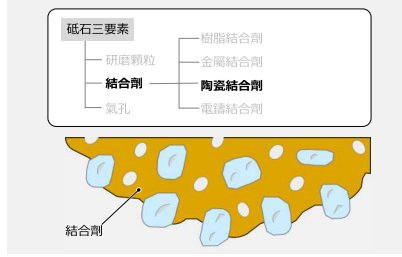


陶瓷結合劑

táo cí jié hé jì

類別：鑽石加工相關

結合劑的一種。由玻璃材質或者陶瓷材質的材料構成的結合劑。耐磨耗性比樹脂結合劑高。剛性高，即使在高負荷加工條件時也可以穩定加工。

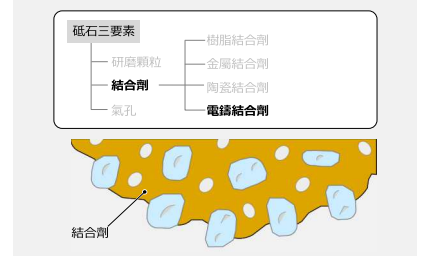


電鍍結合劑

diàn zhù jié hé jì

類別：鑽石加工相關

結合劑的一種。根據電鍍的電鍍成長法製成。具有很強的切削能力。

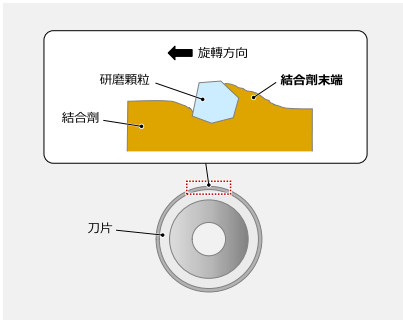


結合劑末端

jié hé jì mò duān

類別：切割刀片

指相對於刀片旋轉方向，研磨顆粒反方向的結合劑湧起的狀態。特別是在刀片切割狀況良好時，經常出現這種狀態。

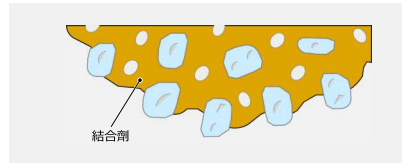


填充劑 / Filler

tián chōng jì / filler

類別：鑽石加工相關

結合劑中添加的填充劑。根據添加的填充劑不同可改變結合劑的特性，可以促進自發刃及確保導電性。

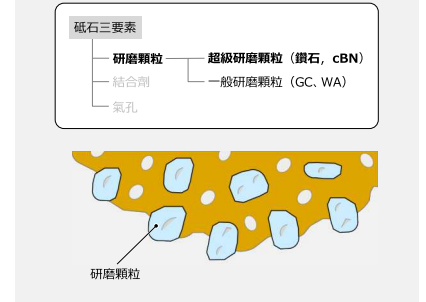


超級研磨顆粒

chāo jí yán mó kē lì

類別：鑽石加工相關

相對於把 GC 及 WA 等稱為普通研磨顆粒，這裡指的是鑽石及 cBN。



普通研磨顆粒

pǔ tōng yán mó kē lì

類別：鑽石加工相關

相對於把鑽石及 cBN 等稱為超級研磨顆粒，這裡指的是 GC 及 WA。比起超級研磨顆粒研磨顆粒本身的破碎性高，做為研磨顆粒的使用壽命相對比較短。



cBN

cBN

類別：鑽石加工相關

指的是立方氮化硼 (cubic boron nitride)。具有僅次於鑽石的強度、因為比鑽石耐熱，會用來加工金屬類的材料。



GC

GC

類別：鑽石加工相關

綠碳化矽 (green silicon carbide)。在 DISCO 主要作為磨刀板的材料、用於刀片及磨輪的真圓度調整及磨刀。

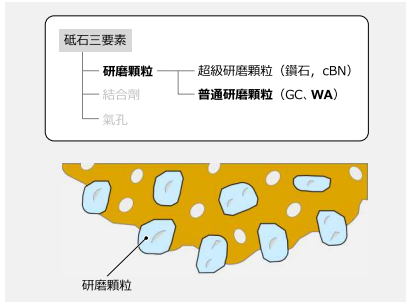


WA

WA

類別：鑽石加工相關

白色氧化鋁粉 (white fused alumina)。在 DISCO 主要作為磨刀板材料、用於刀片及磨輪的圓度調整及磨刀。

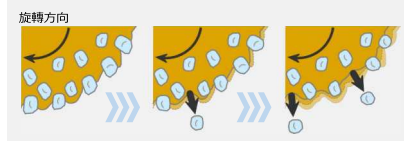


自發刃 / 自銳性 Self-Sharpening

zì fā rèn / zì ruì xìng / self-sharpening

類別：鑽石加工相關

指的是通過加工時排除的加工屑擦過結合劑表面，作用面的結合劑被掘起，磨耗使得研磨顆粒脫落，進而導致新的研磨顆粒出現在表層，使切刃實現可以持續使用循環的狀態。

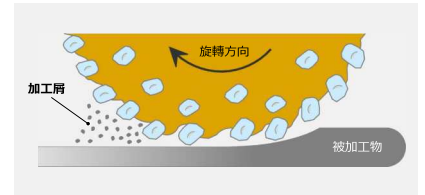


加工屑 / 碎屑 Contamination

jiā gōng xiè / suì xiè / contamination

類別：鑽石加工相關

指的是以切斷·切削·研磨時被除掉的被加工物為主成分的破碎片及，混合物。也指包含這些廢物及混合物的切削水·研削水。

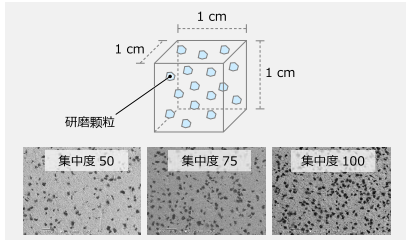


集中度 Concentration

jí zhōng dù / concentration

類別：鑽石加工相關

研磨顆粒層中平均 1cm³ 體積裏所占的研磨顆粒的含有量。數值越大，研磨顆粒層中所含有的研磨顆粒越多。例如，研磨顆粒的含有量為 25% 的情況，顆粒含量則表示為 100。

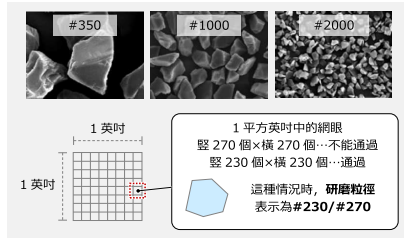


研磨粒徑 / 網眼尺寸

yán mó lì jìng / wǎng yǎn chǐ cùn

類別：鑽石加工相關

研磨顆粒大小的單位。一般用「# (mesh)」和數字來表示，數值越大研磨粒徑越小。由是否能通過某個選好的網眼 (mesh)，作為分類研磨顆粒大小的時候的指標而來。

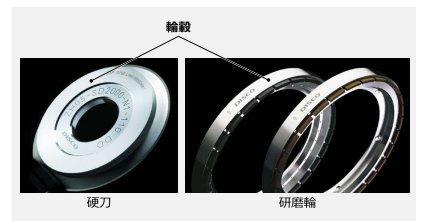


輪殼 / 鋁合金輪殼 基座

lún gǔ / lǚ hé jīn lún gǔ / jī zuò

類別：鑽石加工相關

保持硬刀及研磨輪的研磨顆粒層的金屬基板。

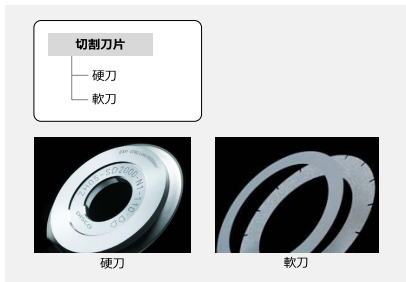


切割刀片

qiē gē dāo piàn

類別：切割刀片

切割機上所搭載，執行被加工物的切斷·開槽等「Kiru (切割)」加工的精密切割工具。由一般耗材研磨顆粒及將其保持的結合劑製成。切割刀片有硬刀與軟刀。

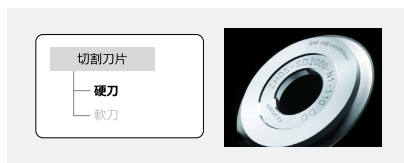


硬刀 / Hub Blade

yìng dāo / hub blade

類別：切割刀片

切割刀片中，鋁合金輪殼一體型的刀片。刀寬很薄的切割刀片也可以簡單使用，主要用於切斷矽晶片及化合物半導體晶圓。



軟刀 Hubless Blade

ruǎn dāo / hubless blade

類別：切割刀片

切割刀片中，刀片中央沒有鋁合金輪殼的墊圈狀的刀片。安裝在軟刀刀座上使用。主要用於電子材料及電子部品 (玻璃、陶瓷、各種半導體封裝) 的單片化切斷。

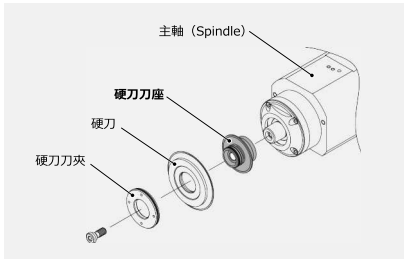


硬刀刀座 Hub Mount

yìng dāo dāo zuò / hub mount

類別：切割刀片

在切割機的主軸 (Spindle) 上用來安裝硬刀、保持穩定的固定具。

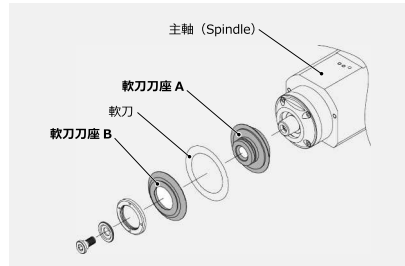


軟刀刀座 / Flange

ruǎn dāo dāo zuò / flange

類別：切割刀片

在切割機的主軸 (Spindle) 上用來安裝軟刀、保持穩定的固定具。

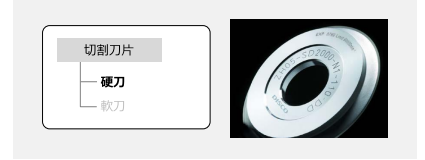


高規格切割刀片 Prime Grade

gāo guī gé qiē gē dāo piàn / prime grade

類別：切割刀片

硬刀中，對於集中度、刀痕寬度、刀刃露出量等規格可以選擇比普通切割刀片更精細規格 (更高精度) 的刀片。此切割刀片對於加工品質或抑制刀片壽命的誤差等品質管理上是可以期待的。

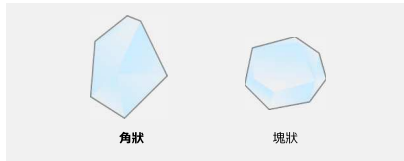


角狀

jiǎo zhuàng

類別：鑽石加工相關

研磨顆粒 (主要為鑽石) 形狀的一種，形狀細長，具較高的外觀比例。反義詞為塊狀。

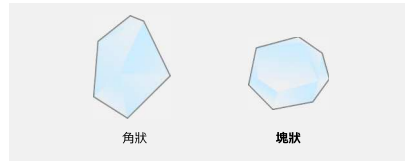


塊狀

kuài zhuàng

類別：鑽石加工相關

研磨顆粒 (主要為鑽石) 形狀的一種。反義詞為角狀。具優異的切削性，研磨粒徑為 #320 以下的粗顆粒為主流。

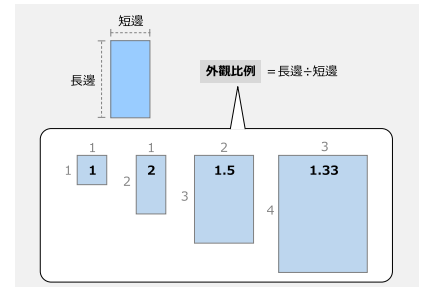


外觀比例

wài guān bǐ lì

類別：鑽石加工相關

表示長 (長邊) 與寬 (短邊) 比例的尺寸。計算式以「長 (長邊) ÷ 寬 (短邊)」表示。數值越大表示形狀越長，數值越接近 1 的話，越接近正方形 (若為研磨顆粒的情況，則越接近圓形) 的形狀。

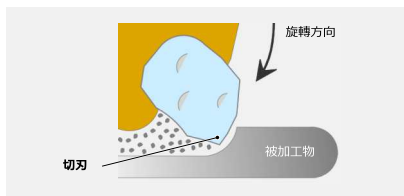


切刃

qiē rèn

類別：鑽石加工相關

指的是在切削或切斷時，被加工物的研磨顆粒銳利之部位。由於加工所造成切刃的磨耗，將導致對被加工物的切削能力變差。

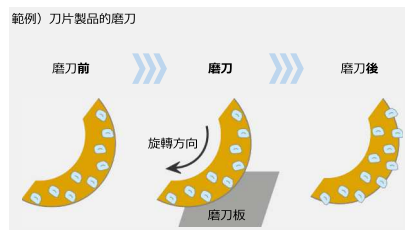


磨刀 / 磨刀修整 / 裸露 Dressing

mó dāo / mó dāo xiū zhěng / luǒ lù / dressing

類別：鑽石加工相關

去除覆蓋研磨顆粒的結合劑，讓研磨顆粒裸露的作業。依研磨粒徑的不同，使用專屬的磨刀板。



磨刀板

mó dāo bǎn

類別：鑽石加工相關

執行磨刀作業所使用的被加工物。通常利用一般紙製成。

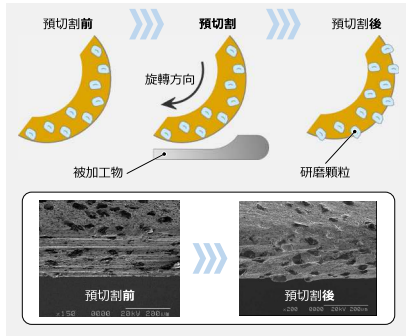


預切割 / Precut

yù qiē gē / precut

類別：鑽石加工相關

實際加工前，為了讓研磨顆粒的排布呈現最佳狀態時所執行的磨合加工。

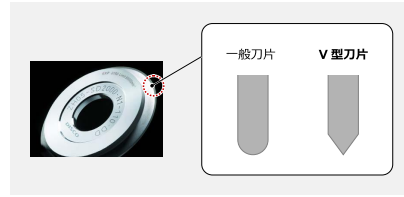


V 型刀片

V xíng dāo piàn

類別：切割刀片

前端具有 V 型角度的切割刀片，於被加工物上使用 V 型刀片執行溝槽加工，稱為 V 型加工。

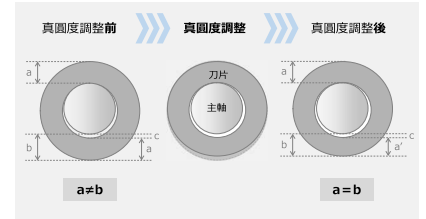


真圓度調整

zhēn yuán dù tiáo zhěng

類別：切割刀片

指的是切割刀片的切削作用面與主軸 (spindle) 中心做同心調整的作業。在偏心狀態或非真圓狀態下高速旋轉的話，對加工品質會造成不良的影響。

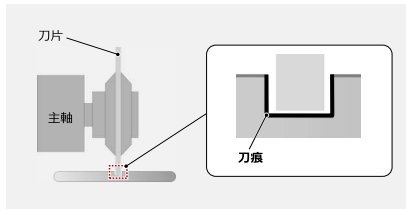


刀痕

dāo hén

類別：切割刀片

使用切割刀片執行加工時，於被加工物上形成的溝槽。

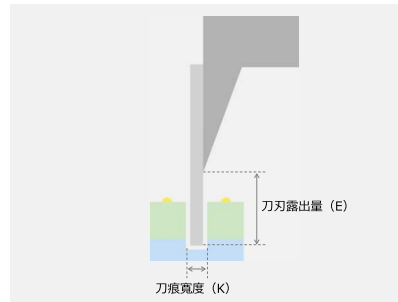


E/K 比

E/K bǐ

類別：切割刀片

出貨時，硬刀片的刀痕寬度 (kerf width) 和刀刃露出量 (exposure) 的比值。計算式以「刀刃露出量 (E) ÷ 刀痕寬度 (K)」表示。

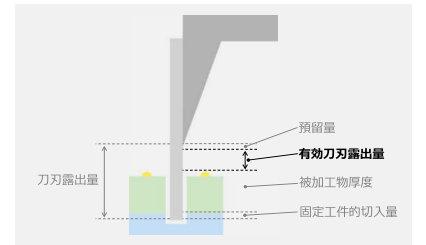


有效刀刃露出量 可使用刀刃露出量

yǒu xiào dāo rèn lòu chū liàng
kě shǐ yòng dāo rèn lòu chū liàng

類別：切割刀片

刀片使用開始至結束的最大磨耗量。刀片的刀刃露出量將預留量、被加工物厚度 (包含焊錫凸塊的突起)，及固定工件的切入量相減後的數值。

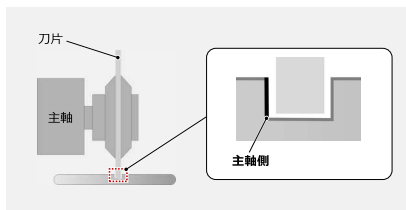


主軸側 / Spindle 側

zhǔ zhóu cè / spindle cè

類別：切割刀片

指的是以被加工物的刀痕處來看，刀片裝載時和硬刀刀座 (或是軟刀刀座) 接觸面的加工側。

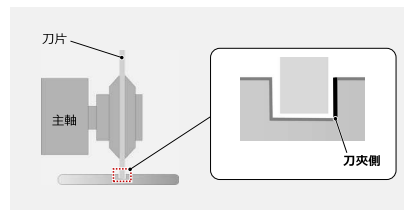


刀夾側 / Nut 側

dāo jiā cè / nut cè

類別：切割刀片

指的是以被加工物的刀痕處來看，和硬刀刀夾 (或是軟刀刀夾) 接觸面的加工側。

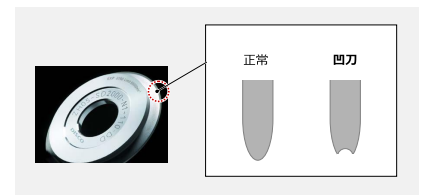


凹刀

āo dāo

類別：切割刀片

加工中，切割刀片前端的中央部位因磨耗而凹陷的狀態。



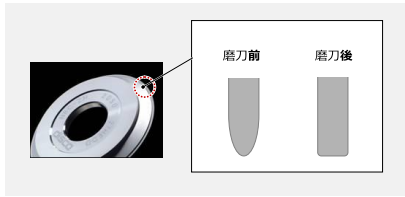
平邊磨刀

Flat Dressing

píng biān mó dāo / flat dressing

類別：切割刀片

將切割刀片的前端修整成平邊形狀的磨刀方式。

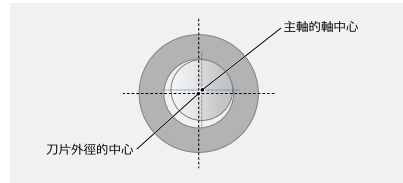


真圓度偏移／偏心

zhēn yuán dù piān yí / piān xīn

類別：切割刀片

刀片外徑的中心和主軸 (Spindle) 的軸中心偏移的狀態。

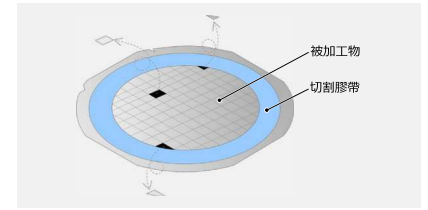


飛晶

fēi jīng

類別：切割刀片

因被切成 Chip 狀而分離的被加工物從切割膠帶上剝離飛散的現象。

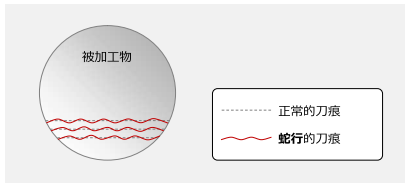


蛇行

shé xíng

類別：切割刀片

從被加工物上方觀察時，刀痕如同波浪狀的狀態。

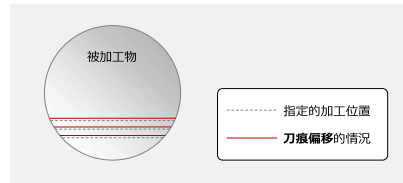


刀痕偏移

dāo hén piān yí

類別：切割刀片

切割刀片並未切入被加工物所指定的加工位置，刀痕中心出現偏移的狀態。

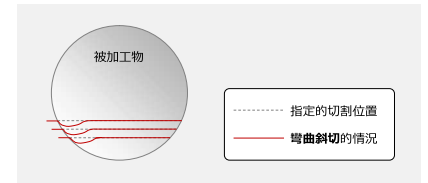


彎曲斜切

wān qū xié qiē

類別：切割刀片

切割線於入刀或出刀時，出現偏移或彎曲的狀態。

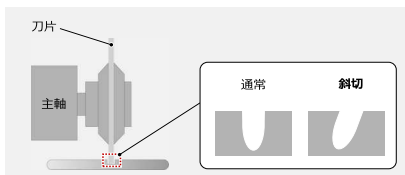


斜切／Slant Cut

xié qiē / slant cut

類別：切割刀片

切割刀片未垂直切入被加工物，刀痕出現彎斜的狀態。

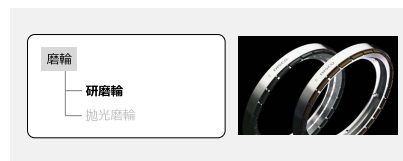


研磨輪

yán mó lún

類別：研磨輪

裝載於研磨機，將矽晶圓或化合物半導體晶圓等被加工物薄化平坦的「Kezuru (削)」加工所使用的砥石。

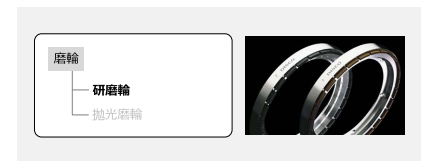


粗研磨輪

cū yán mó lún

類別：研磨輪

在研磨輪中，重視加工效率，粗加工所使用的磨輪。由於研磨顆粒較大，因此研磨時，晶圓表面的粗糙度會變粗。



細研磨輪

xì yán mó lún

類別：研磨輪

指的是利用**細研磨顆粒**做少量研磨，用於去除粗研磨後的破壞層（細研磨）的**研磨層**。



拋光磨輪

pāo guāng mó lún

類別：拋光磨輪

裝載於拋光機，執行「Migaku (磨)」加工以去除背面切削後細微的研磨痕的磨輪。不使用水或藥液，去除晶圓表面上的殘留應力，是為了提高抗折強度的磨輪。



應力釋放 Stress Relief

ying lì shì fàng / stress relief

類別：鑽石加工相關

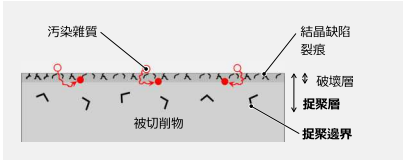
主要去除晶圓表面上的應力層（破壞層），可改善分離後晶粒的抗折強度。

捉聚邊界／捉聚層 Gettering Site

zhuō jù biān jiè / zhuō jù céng / gettering site

類別：拋光磨輪

捉聚邊界主要功能在於捕獲、聚集銅 (Cu) 等金屬雜質。捉聚層是形成於切削面或研磨面，有雜質或結晶缺陷、裂痕之層的總稱。破壞層則在捉聚層的最表面位置。



捉聚乾式拋光磨輪

zhuō jù gān shì pāo guāng mó lún

類別：乾式拋光磨輪

可在切削面或研磨面上形成結晶缺陷、裂痕等（捉聚邊界）的**乾式拋光磨輪**。



移除量／移除體積 移除厚度

yí chú liàng / yí chú tǐ jī / yí chú hòu dù

類別：研磨輪／乾式拋光磨輪

利用**研磨輪**加工（切削）及**乾式拋光磨輪**加工（研磨），晶圓等被切削物被加工的量（切削量、研磨量）。

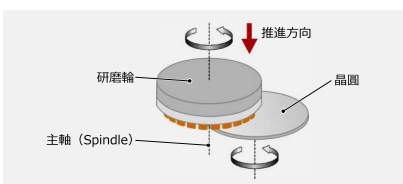


軸向進給／In-Feed

zhóu xiàng jìn gěi / in-feed

類別：研磨輪

研磨方法的一種。相對於自轉的晶圓等被切削物，**研磨輪**沿著主軸線往推進方向進給的方式。為了讓研磨輪以圓弧的一半和晶圓接觸，將工作盤 (Chuck Table) 以傘狀傾斜狀態做切削、研磨。和**深進緩給**方式相較，加工負荷小，薄化容易。

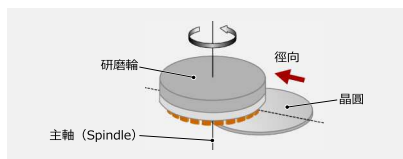


深進緩給 Creep-Feed

shēn jìn huǎn gěi / creep-feed

類別：研磨輪

研磨方法的一種。**研磨輪**的高度方向固定，晶圓等被切削物相對於主軸朝徑向低速進給的研磨方式。

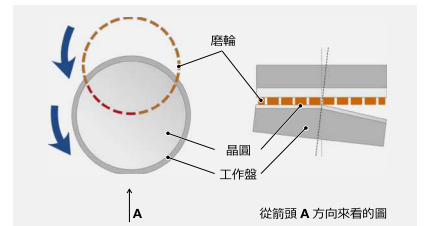


工作盤傾斜

gōng zuò pán qīng xié

類別：研磨輪

指在**軸向進給**研磨時，為了降低加工負荷讓磨輪得以用半圓狀做研磨，因此將工作盤 (Chuck Table) 傾斜成傘狀的狀態。也指當時工作盤的傾角。

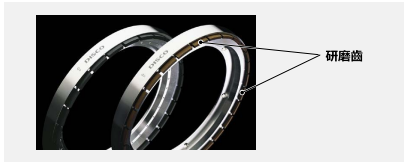


研磨齒

yán mó chǐ

類別：研磨輪

意指研磨輪的鑽石層（砥石部位）。

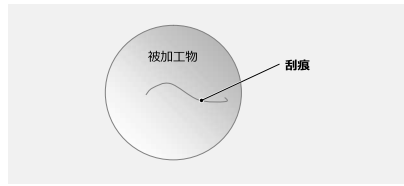


刮痕／Scratch

guā hén / scratch

類別：研磨輪

加工不良的一種。在晶圓等被加工物研磨面上損傷的總稱。

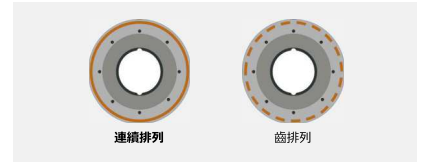


連續排列

lián xù pái liè

類別：研磨輪

研磨輪刀刃的排列方法之一。沒有研磨齒間隔的磨輪。以改善研磨齒的缺陷或提高加工品質為目的。

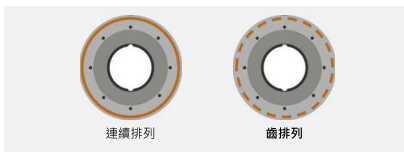


齒排列

chǐ pái liè

類別：研磨輪

研磨輪刀刃的排列方法之一。將磨輪的研磨齒以固定的間隔做排列。

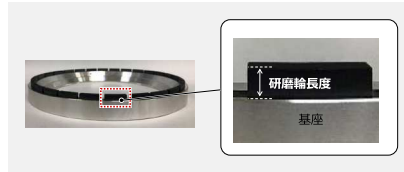


研磨齒長度

yán mó chǐ cháng dù

類別：研磨輪

意指研磨輪的研磨齒於基座的突出量。



研磨齒寬度／刀刃寬

yán mó chǐ kuān dù / dāo rèn kuān

類別：研磨輪

研磨輪刀刃和晶圓接觸的面，研磨齒於磨輪直徑方向的尺寸。



自體研磨 Self-Grinding

zì tǐ yán mó / self-grinding

類別：研磨輪

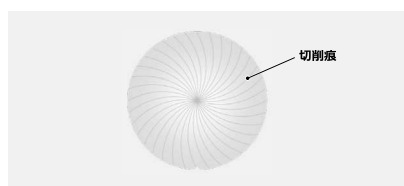
為了使工作盤（Chuck Table）和主軸（Spindle）的傾角正常，以保持研磨精度的作業。於機台安裝自體研磨用的磨輪後，直接對工作盤表面進行移除。由於是進行機台部自體的切削而非被加工物的切削，故稱之。

切削痕／磨痕 Saw Mark

qiē xiāo hén / mó hén / saw mark

類別：研磨輪

發生於被切削物的切削面，較深的切削痕。



表面粗糙度

biǎo miàn cū cāo dù

類別：磨輪相關

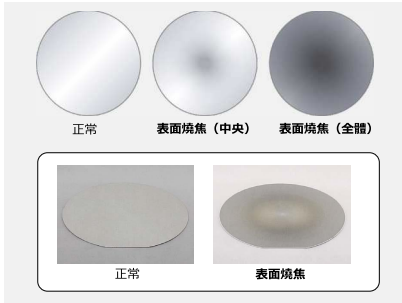
量測被加工物的切削面、研磨面的凹凸起伏計算出的數值。通常指平均高度及最大高度差。

表面燒焦／Burning

biǎo miàn shāo jiāo / burning

類別： 研磨輪

加工不良的一種。由於研磨齒部位的鑽石研磨顆粒脫落、磨耗使得加工負荷增加，導致異常發熱，因此使晶圓等被加工物的切削、研磨面變色。

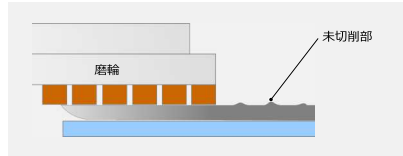


表面修整 Spark Out

biǎo miàn xiū zhěng / spark out

類別： 研磨輪

被切削物達到指定厚度時保持磨輪高度 (Z 軸位置)，Z 軸方向不做額外地研磨加工，利用彈性變形將未切削部移除，以修整研磨表面的過程。



退出加工 Escape Cut

tuì chū jiā gōng / escape cut

類別： 研磨輪

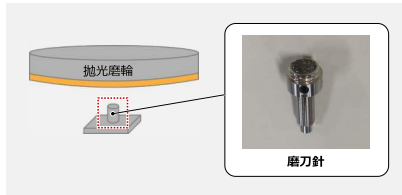
表面修整後，研磨輪緩慢地往上方退出的過程。會影響加工面的狀態。

磨刀針

mó dāo zhēn

類別： 乾式拋光磨輪

裝載於拋光機，進行乾式拋光磨輪的磨刀工具，為磨耗品。



磨輪壽命

mó lún shòu mìng

類別： 磨輪相關

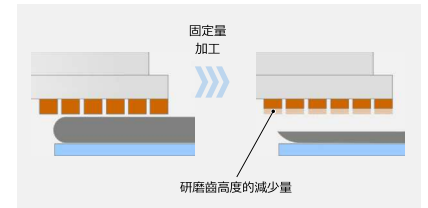
意指單獨磨輪可加工之被切削物的片數。

磨耗量

mó hào liàng

類別： 磨輪相關

意指固定量 (片數或移除量) 下，砥石的磨耗量。基本上，以研磨齒高度的減少量表示。

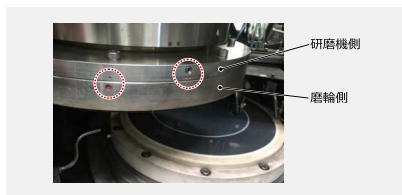


對位標記

duì wèi biāo jì

類別： 磨輪相關

研磨機裝載磨輪時，決定位置的參考標記。

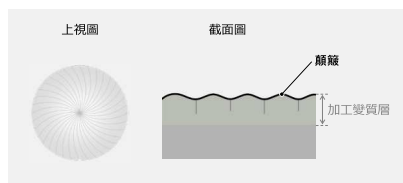


顛簸

diān bō

類別： 研磨輪

加工不良的一種。因為晶圓表面上周期性的起伏，導致可以目視確認研磨面顏色不同 (濃淡) 的狀態。



腐蝕／溶化／溶解

fǔ shí / róng huà / róng jiě

類別： 鑽石加工相關

由於加工時使用純水的影響，使結合劑成分有溶出的現象。導致刀刃強度的降低。此現象特別常見於電鍍結合劑或陶瓷結合劑。

旋轉中心偏移量

xuán zhuǎn zhōng xīn piān yí liàng

類別：磨輪相關

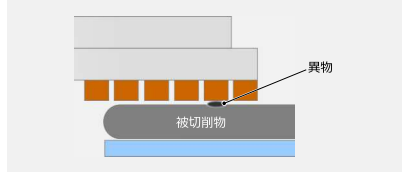
指的是旋轉物體的垂心和旋轉中心的偏移量。

異物附著

yì wù fù zhuó

類別：研磨輪

指的是被切削物上的異物附著於研磨輪進行切削的狀況。有時會造成晶圓刮痕或破裂的原因。

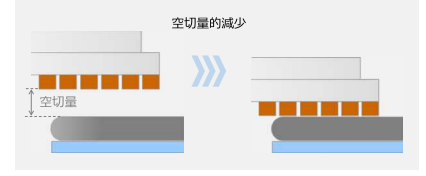


研磨撞擊

yán mó zhuàng jī

類別：磨輪相關

指的是由於測高的不良或是晶圓厚度不均,使得空切量變少時,磨輪於下降中以高速和被切削物碰撞的狀態。

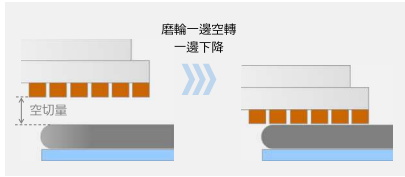


空切 / Air Cut

kōng qiē / air cut

類別：研磨輪

從比被切削物厚度更高的位置,以跟加工相同的速度,使研磨輪一邊空轉一邊降下的過程。



打滑

dǎ huá

類別：研磨輪

由於主軸扭矩的不足, 研磨輪無法切入被切削物的狀態。

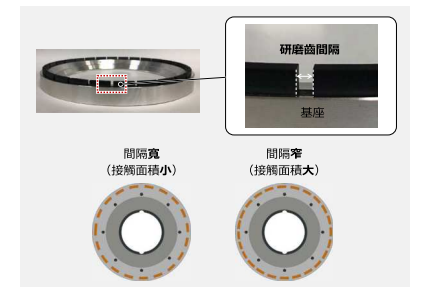


研磨齒間隔

yán mó chǐ jiàn gé

類別：研磨輪

在研磨輪上, 研磨齒之間相鄰的間隔。利用間隔的調整,可改變研磨齒與晶圓的接觸面積,進而調整磨輪的加工能力。

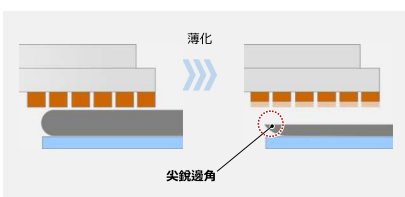


尖銳邊角 Sharp Edge

jiān ruì biān jiǎo / sharp edge

類別：研磨輪

指的是薄化被切削物的時候,外圍部的截面形狀變成銳利的狀態。亦指變成銳利狀態的部位。

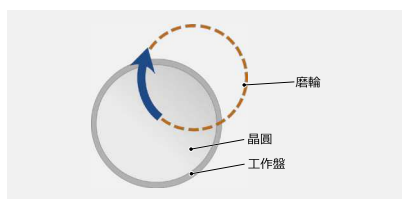


內外研磨

nèi wài yán mó

類別：研磨輪

指的是研磨輪從晶圓中心向晶圓邊緣研磨的動作。

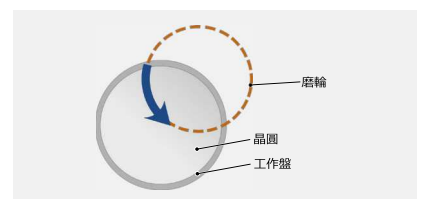


外內研磨

wài nèi yán mó

類別：研磨輪

指的是研磨輪從晶圓邊緣向晶圓中心研磨的動作。

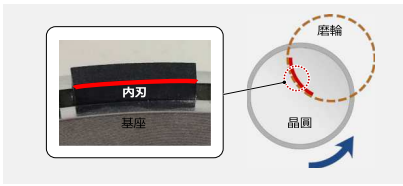


內刃

nèi rèn

類別：研磨輪

指的是研磨盤的內緣側，以及以內緣側為加工點去切削的動作。

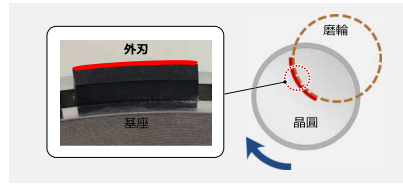


外刃

wài rèn

類別：研磨輪

指的是研磨盤的外緣側，以及以外緣側為加工點去切削的動作。

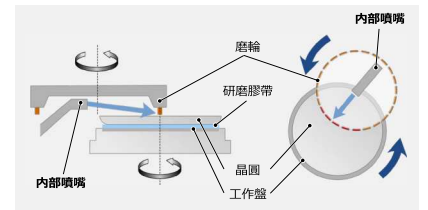


內部噴嘴

nèi bù pēn zuǐ

類別：研磨輪

指的是內刃做切削時，直接提供加工點切削水的噴嘴。

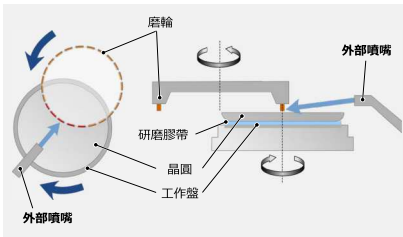


外部噴嘴

wài bù pēn zuǐ

類別：研磨輪

指的是利用外刃做切削時，直接提供加工點切削水的噴嘴。

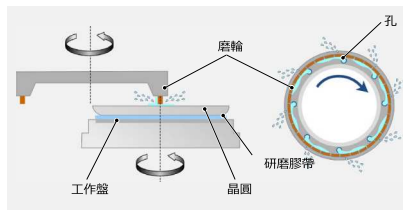


磨輪切削水

mó lún qiē xiāo shuǐ

類別：研磨輪

利用來自於主軸(Spindle)供給的切削水，從磨輪基座開孔處提供給加工點。



邊緣裂角

Edge Chipping

biān yuán liè jiǎo / edge chipping

類別：研磨輪

被加工物的邊緣處發生裂角，主要是粗研磨所造成。

